

기술분석보고서 산업재

성우테크론(045300)

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

작성기관 나이스평가정보(주) 작성자 주예령 연구원

[YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미공개 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)로 연락하여 주시기 바랍니다.

성우테크론(045300)

반도체 후공정을 꺾는 검사 전문 기업

기업정보(2026.06.11 기준)

대표자	박찬홍
설립일자	1997.04
상장일자	2001.12
기업규모	중소기업
업종분류	그 외 기타 전자부품 제조업
주요제품	반도체 리드 프레임 등

시세정보(2026.06.11 기준)

현재가(원)	2,870
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	307
발행주식수	10,547,012
52주 최고가(원)	3,845
52주 최저가(원)	2,650
외국인지분율	3.22
주요주주	박찬홍 외 4인

■ 반도체 후공정 검사장비·임가공·AI 솔루션 전문기업

동사는 1993년 6월 성우정밀 설립을 모태로 출발하여 1997년 법인전환 이후 반도체 검사장비 제조 및 후공정 임가공 사업을 양측으로 성장해 온 기업으로 평가된다. 2001년 코스닥시장 상장을 통해 자본시장에 진입하였으며, 장비사업부·부품사업부·PCB사업부의 3개 사업부문과 AI솔루션사업부를 유기적으로 운영하며 반도체 공급망 내 안정적 위치를 구축하고 있는 것으로 확인된다.

■ 비전 알고리즘·AI 딥러닝 기반의 기술 중심 기업

동사의 핵심 경쟁력은 IT·디지털 자동화 분야에서 20년 이상 축적한 정밀 메카트로닉스 기술과 비전 검사 알고리즘 내재화에 있는 것으로 판단된다. LOC·PCB·COF 등 다양한 반도체 후공정 제품에 대응하는 2D·3D 검사장비를 자체 개발·생산하고 있으며, 16건 이상의 등록 특허와 자체 개발 딥러닝 AI 비전 솔루션(SaiDAS·SaiBis), 미국 코그넥스社와의 PSI 파트너십을 기반으로 AI 검사 솔루션 사업부를 별도 운영하고 있는 것으로 확인된다. 삼성전기·엘지이노텍·해성DS(주) 등 국내 반도체 핵심 부품사를 주요 고객사로 확보하여 안정적인 수주 기반을 구축하고 있는 것으로 평가된다.

■ 이차전자·전장 시장 진입으로 성장 다각화 추진

동사는 기존 반도체 검사장비·임가공 역량을 기반으로 자동차용 검사장비 및 이차전자용 검사장비 분야로의 사업 영역 확장을 본격화하고 있는 것으로 파악된다. 2018년 전지 자동검사기 25대 납품실적을 바탕으로 인터배터리 2024·2025 전시회에 연속 참가하며 배터리 관련 사업 역량을 대외에 공개하고 있으며, 국내 반도체 검사장비 시장은 향후 고성장 전망과 맞물려 중장기 수익 기반 강화가 기대되는 것으로 평가된다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2023	337.8	-23.9	-8.1	-2.4	-10.5	-3.1	-1.53	-1.12	35.8	-99	6,646	N/A	0.59
2024	416.9	23.4	11.8	2.8	22.5	5.4	3.26	2.27	39.5	212	6,842	11.66	0.36
2025	409.2	-1.8	19.5	4.8	47.5	11.6	6.58	4.72	33.2	449	7,300	6.54	0.40

기업경쟁력

반도체 후공정 전용 비전 검사 기술 내재화

- 20년 이상 축적한 비전 검사 알고리즘·정밀 메카트로닉스 기술 기반의 LOC-PCB-COF 등 다양한 후공정 부품 검사장비 자체 개발 역량 보유
- 리드프레임 등속검사장치(10-2039117), 칼라 고해상도 기판 검사시스템(10-2953021) 등 16건 이상 등록 특허로 기술 방어선 구축
- 100% 수주 기반 주문생산 방식으로 고객사별 공정 요구에 맞춘 맞춤형 장비 공급 가능

대형 고객사 장기 공급 관계 및 안정적 수주 기반

- 삼성전기·엘지이노텍·해성DS(주)·엘에스전선(주) 등 국내 반도체 핵심 부품사와 장비·부품·PCB 3개 사업부 연계 복수 공급 관계 유지
- 상위 2개 고객사 매출 집중도 약 62%로 안정적 수요 기반 확보
- 1993년 창업 이래 30년 이상 누적된 고객 신뢰 및 레퍼런스 기반 수주 경쟁력 보유

핵심 기술 및 적용제품

반도체 후공정 검사장비 (장비사업부)

- LOC-PCB-COF·자동차용·전지용 등 다양한 반도체 부품에 대응하는 2D·3D 자동 검사장비 설계·제조·납품으로, 비전 알고리즘 내재화 및 패키지기판 커버시트 부착·제거 공정 기술까지 보유

AI 딥러닝 비전 솔루션 (AI솔루션사업부)

- 자체 개발 딥러닝 검사 솔루션 SaiDAS·SaiBis와 미국 코그넥스社 PSI 파트너십을 기반으로 산업용 바코드 리더기·스마트카메라·딥러닝 솔루션 등 AI 검사 제품군 공급

<동사 PCB 장비>



시장경쟁력

국내 반도체 검사장비 시장 고성장 수혜

- 국내 반도체 검사장비 시장은 2023년 1조 1,234억 원에서 2028년 2조 1,961억 원으로 CAGR 14.4% 성장이 전망되어, 동사 장비사업부의 구조적 수요 확대 기반 확보

이차전지·자동차 전장 신시장 진입 추진

- 2018년 전지 자동검사기 25대 납품 실적 및 인터배터리 2024·2025 연속 참가를 기반으로 이차전지·전장 검사 시장 진입 본격화, 반도체 업황 변동에 대한 완충 효과 기대

글로벌 AI 비전 검사 시장 확장 기반 보유

- 글로벌 반도체 계측·검사장비 시장 CAGR 6.9% 성장 전망 속, 코그넥스社 파트너십 및 자체 AI 솔루션을 통해 국내외 AI 검사 솔루션 시장 공략 기반 구축

I. 기업 현황

반도체 후공정 검사장비·임가공·AI 비전 솔루션 전문기업

동사는 반도체 후공정 검사장비 제조와 리드프레임·PCB 임가공을 주력으로 영위하며, 자체 개발 AI 비전 솔루션(SaiDAS/SaiBis) 및 美코그넥스社 파트너십을 기반으로 삼성전기·엘지이노텍·해성DS(주) 등 국내 반도체 핵심 부품사에 납품하는 일관 사업체계를 보유하고 있는 것으로 평가된다.

■ 기업 개요 및 주요 연혁

동사는 1993년 6월 리드프레임 설비 제작을 목적으로 성우정밀을 설립한 이후, 1997년 4월 성우테크론주식회사로 법인전환하여 경영 체계를 정비하고 동년 11월 엘지전선·삼성테크윈에 리드프레임 양산 납품을 개시한 반도체 후공정 전문기업인 것으로 확인된다. 2001년 코스닥시장 등록을 통해 자본시장에 진입하였으며, 동년 ISO 9001:2000 인증 취득을 통해 품질경영 체계를 공식화한 것으로 파악된다. 2007년 엘에스전선향 플렉시블 플랫 케이블(FFC) 양산을 개시하며 사업 영역을 확장하였고, 2008년 대전사업장을 준공하여 PCB 최종검사 사업 기반을 추가로 확보한 것으로 확인된다. 이후 2011년 창원 성주공장 신축과 리드프레임 일괄생산라인 완공으로 생산 역량을 대폭 강화하였으며, 2013년 자동차 에어백용 플렉시블 플랫 케이블 개발·양산, 2017년 관계회사 성우미크론(주) 설립, 2018년 전지 자동검사기 25대 납품(70억 원) 및 수출의 탑(오백만불탑) 수상, 2021년 美코그넥스社와의 PSI 파트너십 체결 및 딥러닝 솔루션 양산 적용, 2022년 3D 모듈 공급 개시 등 기술 고도화와 사업 영역 확장을 지속적으로 추진해 온 것으로 평가된다.

그림 1. 주요 연혁



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03), NICE평가정보(주) 재가공

■ 대표이사 주요 이력

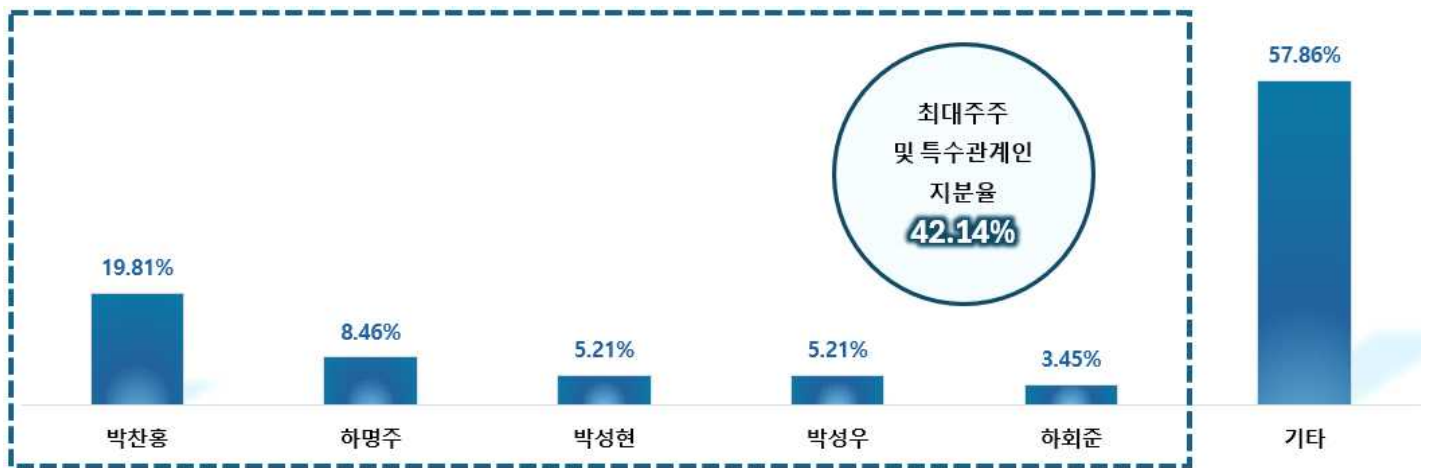
동사의 대표이사 박찬홍은 경남대학교 공과대학 전자공학과를 졸업하고, 삼성항공산업(주) 입사 및 삼성그룹 이견희 회장 표창 수여를 통해 대기업 현장에서 기술·생산 역량을 검증받은 것으로 확인된다. 이후 1997년 동사의 전신인 성우정밀을 창업하여 법인 설립부터 현재까지 28년간 경영을 이끌어 온 창업자 대표로, 중소기업청장이 수여하는 '이달의 벤처기업인상'을 수상한 바 있어 기업가적 역량도 대외적으로 인정받은 것으로 평가된다. 2024년 정기주주총회에서 재선임되어 2027년 3월까지 임기가 확정되어 있으며, 성우미크론(주) 사내이사 및 성우세미텍(주) 사내이사를 겸임하는 등 연관 계열사 경영을 총괄하고 있는 것으로 파악된다.

성우테크론(045300)

■ 주주 현황

동사의 주주현황을 살펴보면, 최대주주는 대표이사 박찬홍으로 2,088,798주(19.81%)를 보유하고 있다. 특수관계인으로는 하명주 892,613주(8.46%), 박성현 549,736주(5.21%), 박성우 549,736주(5.21%), 하회준 364,106주(3.45%)가 지분을 보유하고 있는 것으로 확인된다. 이를 종합할 때 최대주주 및 특수관계인 합산 지분은 4,444,989주(42.14%) 수준으로, 직전 대비 소폭 증가하며 안정적인 지배구조가 유지되고 있는 것으로 판단된다.

그림 2. 주주 현황



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03), NICE평가정보(주) 재가공

■ 사업 분야

동사는 장비사업부, 부품사업부, PCB사업부의 3개 사업부문을 중심으로 사업을 영위하고 있다.

표 1. 주요 사업 분야

부문	사업부	품목	제품 설명
완제품 매출	장비사업부	LOC, PCB 검사장비 자동차용 검사장비 전지용 검사장비	반도체 후공정 부품의 가공·2D·3D 검사를 위한 자동화 장비 설계·제조·납품
	부품사업부	메모리 칩 핵심부품 PC, TV, 항공기, 자동차 및 트랜지스트 핵심부품	무상사급 방식의 메모리 칩 리드프레임 등 핵심 부품 가공, 해성DS(주)·엘에스전선(주) 납품
임가공 매출	PCB사업부	메모리 칩 핵심부품 스마트 폰, 휴대폰 등	BGA 관련 PCB 최종 검사 임가공, 삼성전기·스팀코 납품

자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03), NICE평가정보(주) 재가공

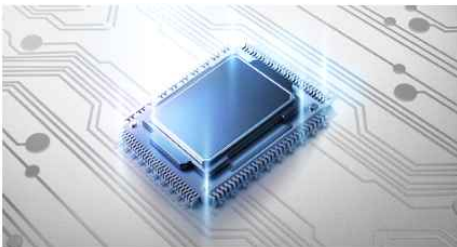
성우테크론(045300)

장비사업부는 반도체 후공정 부품의 가공·검사를 위한 자동화 장비를 설계·제조·납품하는 사업부문으로, LOC·PCB·COF·자동차용·전자용 등 다양한 반도체 부품에 대응하는 검사장비 라인업을 보유하고 있다. 비전 기반 검사 알고리즘과 정밀 메카트로닉스 기술을 내재화하고 있으며, 100% 수주 기반의 주문생산 방식으로 고객사별 공정 요구에 맞춘 맞춤형 장비 공급이 가능하다. 삼성전기·엘지이노텍·해성DS(주) 등 국내 반도체 핵심 부품사를 주요 고객으로 확보하고 있으며, 동사의 기술 경쟁력이 집약된 핵심 사업부문으로 평가된다.

부품사업부는 메모리 칩 핵심부품인 리드프레임(LOC·TR) 및 반도체 IC에 대한 후공정 임가공을 영위하는 사업부문으로, 고객사 무상사급 방식의 원재료 조달 구조를 기반으로 PC·TV·자동차·항공기용 반도체 부품 가공을 수행하고 있다. 해성DS(주)·엘에스전선(주) 등 리드프레임 전문 제조사와의 안정적 공급 관계를 바탕으로 고객사 생산 물량 변화에 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖추고 있으며, 1993년 성우정밀 창업 이래 30년 이상 축적된 리드프레임 가공 기술력이 해당 사업의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있는 것으로 평가된다.

PCB사업부는 메모리 반도체의 BGA 관련 인쇄회로기판(PCB)에 대한 최종검사 임가공을 영위하는 사업부문으로, 반도체 칩을 PCB 기판에 직접 실장하는 차세대 고속 반도체용 기판의 전수 검사 공정을 담당하고 있다. 삼성전기·스탬코 등을 주요 고객사로 하여 무상사급 방식으로 운영되며, 동사가 자체 개발한 검사장비 및 비전 알고리즘을 PCB 검사 공정에 직접 적용함으로써 품질 신뢰성과 공정 손실 최소화를 동시에 구현하고 있는 것으로 파악된다.

그림 3. 동사 주요 사업부 구성



부품사업부 (자회사포함)

- Lead Frame · 반도체 칩을 연결하는 전기도선 · 반도체를 지지해 주는 버팀대
- FFC 생산 (Flexible Flat Cable) · 전자제품 내부 배선용 Cable



장비사업부

- 반도체 제조장비 및 자동검사장비 (개발 > 설계 > 프로그래밍 > 제조)
- 정밀 메카트로닉스 기술과 비전 기술을 확대 발전



PCB사업부

- Mobile/IT 핵심 Package 기판
- 반도체와 메인보드간 전기적 신호 전달체계

자료: 동사 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

동사는 2025년 2월 인터배터리 2025 전시회에 참가하여 이차전지용 검사장비 관련 역량을 대내외에 공개하는 등 신사업 확장 행보를 본격화하고 있는 것으로 파악된다. 장비사업부 내 기존 LOC·PCB 검사장비 경쟁력을 자동차 전장 및 이차전지 분야에 접목하는 전략을 추진 중이며, 엘지이노텍을 주요 고객사로 확보하는 등 전기차 관련 부품 검사 수요 증가에 선제적으로 대응하고 있는 것으로 확인된다.

향후 동사는 반도체 업황 회복 사이클과 AI 반도체 투자 확대에 따른 후공정 검사장비 수요 증가에 수혜가 예상되며, 2026년 칼라 고해상도 기판 검사시스템 특허를 신규 등록하는 등 신제품 기술 개발을 지속적으로 추진하고 있는 것으로 평가된다. 또한 연간 연구개발비를 약 13.92억 원(매출 대비 약 3.40%) 수준으로 꾸준히 유지하며 기술 혁신 투자를 지속하고 있어, 중장기적인 제품 경쟁력 강화 기반이 마련되고 있는 것으로 전망된다.

II. 시장 동향

반도체 후공정 검사장비·임가공 시장, AI 사이클 수혜 속 성장 국면 진입

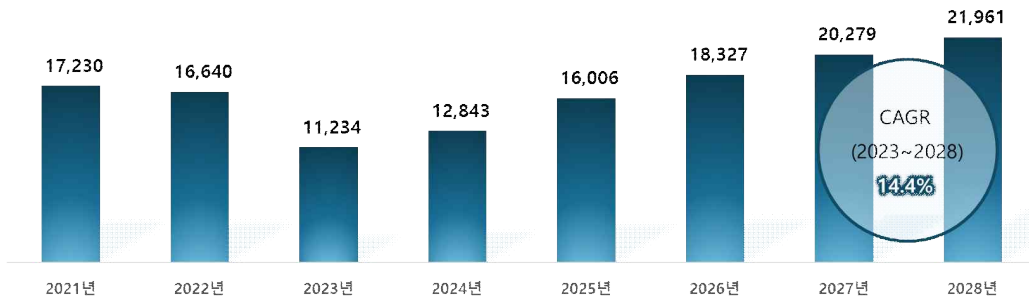
국내 반도체 검사장비 시장은 고성장이 전망되며, AI·HBM 수요 확대에 따른 고정밀 검사장비 투자 증가가 구조적 성장을 뒷받침하고 있는 것으로 파악된다. 당사는 후공정 전용 비전 검사 알고리즘과 AI 딥러닝 솔루션을 기반으로 성장 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 기술 기반을 갖추고 있다.

■ 국내 반도체 검사장비 시장

Markets and markets(2025)에 따르면 국내 반도체 검사장비 시장은 2023년 기준 1조 1,234억 원 규모로 형성되어 있으며, 2024년부터 지속적인 상승세로 전환되어 2028년에는 2조 1,961억 원 규모로 확대될 것으로 전망된다. 2023년~2028년 동안 연평균 14.4%의 높은 성장세가 기대되며, 이는 주요 반도체 제조업체의 대규모 설비투자 확대 및 AI·HBM 수요에 따른 고정밀 검사장비 교체 수요 증가가 핵심 성장 동인으로 작용하고 있는 것으로 파악된다.

그림 4. 국내 반도체 검사장비 시장 규모 및 전망

(단위: 억 원)



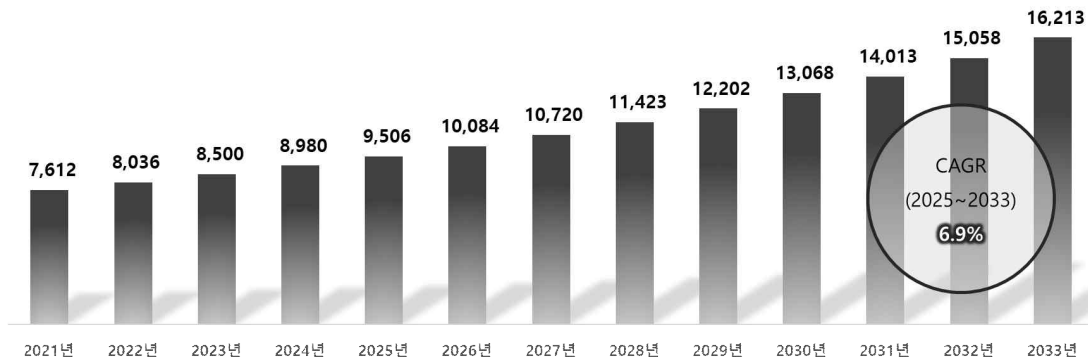
자료: Markets and markets(2025), NICE평가정보(주) 재가공

■ 글로벌 반도체 계측·검사 장비 시장 규모 및 성장률

글로벌 반도체 계측·검사 장비 시장은 Grand View Research(2025)에 따르면 2024년 89억 8,040만 달러 규모로 평가되었으며, 2033년까지 162억 1,330만 달러로 확대되어 2025년에서 2033년 동안 연평균 6.9%의 안정적 성장이 전망된다. 아시아 태평양 지역은 2024년 최대 매출 시장을 형성하고 있으며, 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 제조사를 중심으로 한 국내 설비투자 확대가 기대된다.

그림 5. 글로벌 반도체 계측·검사 장비 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



자료: Grand View Research(2025), NICE평가정보(주) 재가공

■ 시장 구조 및 산업동향

반도체 후공정 검사장비 시장은 국내외 반도체 대기업의 설비투자 사이클에 직접적 영향을 받으며, AI 가속기·HBM·고성능 메모리 수요 확대에 따른 후공정 중요도 상승으로 검사장비 고도화 수요가 증가하고 있는 것으로 파악된다. 전공정 검사장비는 KLA·Applied Materials 등 글로벌 기업이 주도하는 반면, 후공정 검사장비 분야에서는 국내 전문기업의 기술 경쟁력이 상대적으로 높은 수준으로 평가되며, 독자적 알고리즘과 3D 측정 기술을 보유한 국내 업체들이 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 확인된다. 아울러 전기차 전장 부품 및 이차전지 분야의 검사 수요가 급증하면서 기존 반도체 장비 전문기업들의 신규 시장 진입이 활발해지고 있으며, 동사 역시 이 흐름에 적극 대응하고 있는 것으로 파악된다.

■ 기술 개발 및 경쟁 환경

반도체 후공정 검사장비 및 임가공 산업은 고정밀 비전 알고리즘과 자동화 설비를 기반으로 하는 기술집약적 산업이자, AI·HBM 등 차세대 반도체 수요 확대에 대응하는 지속적인 기술 고도화가 경쟁력의 핵심으로 작용하는 시장으로 평가된다.

최근 글로벌 시장에서는 AI 기반 딥러닝 비전 검사, 3D 계측 기술, 고속·고정밀 자동화 이송 시스템, 차세대 패키지기판(패널레벨패키지·유리기판) 대응 공정 장비 개발이 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있으며, KLA Corporation·Applied Materials·Onto Innovation 등 글로벌 대형 업체들은 AI 검사 플랫폼과 첨단 계측 기술 통합, 고객 맞춤형 공정 솔루션을 중심으로 기술 경쟁을 심화시키고 있는 것으로 확인된다.

국내 시장에서 후공정 검사장비 부문은 고영테크놀러지·유니테스트·넥스틴 등이 주요 경쟁업체로 활동하고 있으며, 리드프레임·PCB 임가공 부문은 해성DS(주)·스탬코 등 소재 제조사와의 수직계열화 구조가 공급 안정성과 가격 경쟁에 영향을 미치고 있는 것으로 파악된다. 향후에는 AI 비전 검사 알고리즘의 고도화, 차세대 반도체 기판 대응 장비 개발 역량, 원가 경쟁력 및 고객 대응 속도가 경쟁우위를 좌우할 가능성이 높은 것으로 판단된다.

표 2. 국내 경쟁업체 현황

기업명	주요 사업 내용
테크윙(주)	- 반도체 후공정 테스트 핸들러 전문기업 - 메모리 핸들러 글로벌 점유율 1위를 유지하며 SK하이닉스·삼성전자·마이크론 등 글로벌 반도체 기업에 납품함
(주)넥스틴	- 2010년 설립된 전공정 광학 검사장비 전문기업 - KLA텐코가 독점하던 다크필드 검사장비 시장에 진입하여 글로벌 반도체 기업들의 구매처 다변화 수요를 공략하고 있음
유니테스트(주)	- 메모리 테스트 장비 전문기업 - SK하이닉스·삼성전자·마이크론 등에 Cube Prober-Probe Station 등 검사장비를 공급하며 HBM 테스트 대응 신제품 개발에 주력하고 있음

자료: 업체 홈페이지 및 보도자료, NICE평가정보(주) 재가공

III. 기술분석

반도체 후공정 비전 검사-자동화 기술 기반 AI 솔루션으로의 확장

동사는 20년 이상 축적한 비전 검사 알고리즘과 정밀 자동화 기술을 기반으로 LOC-PCB-COF 등 다양한 반도체 부품 검사장비 기술력을 보유하고 있다. 아울러 자체 개발한 AI 비전 솔루션(SaiDAS-SaiBis) 및 차세대 패키지기판 공정 기술을 통해 신규 시장으로의 확장을 지속하고 있다.

■ 반도체 후공정 부품 전용 고속·고정밀 비전 검사 기술

동사는 IT·디지털 자동화 분야에서 20년 이상 축적한 정밀 메카트로닉스 기술과 비전 기술을 핵심 역량으로 보유하고 있다. 특히 초경량·초미세 반도체 부품에 특화된 검사 알고리즘을 자체 개발함으로써 차세대 검사 알고리즘 최적화 기술을 구현하고 있으며, LOC·IC·PCB·COF 등 다양한 반도체 후공정 부품의 상면반사·하면반사·투과 검사를 단일 장비 내에서 처리하는 다기능 검사 역량을 갖추고 있다. 대표 특허인 '리드프레임 등속검사장치'(10-2039117)와 '칼라 고해상도 기판 검사시스템'(10-2953021)은 마스터이미지와의 실시간 매칭률 비교 및 기판 전·후면 동시 촬상을 통해 검사 정밀성과 공정시간 단축을 동시에 구현하며, 이를 통해 삼성전기·엘지이노텍 등 주요 고객사의 수율 관리와 품질 신뢰성 확보에 핵심적으로 기여하고 있다.

그림 6. 동사 PCB 장비



DEFECTS	CONTENTS
Metal Defect	Discolor, Contamination, Nodule, Non-plating(shallow type), Pin Hole, Pad defects, Cu exposure, Dent, Metal F/M, Space defect, Scratch, Pit, ink F/M, Protrusion & Nick (Mouse Bite), etc
SR Defect	Transparency F/M, Scratch, Crack, Cu Residue, SR Lump, Peeling, Void, Stain, Shift, Delamination, AOI, Whiteness, SR DAM, etc.
Pattern	Open, Short, Loss, Protrusion, Nick, VH Exposure, etc
Substrate Dummy	Hole Break, Mold gate, Dummy Damage, OCR, 2D Barcode

자료: 동사 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

■ 반도체 부품 정밀 이송·가공 공정 자동화 기술

동사는 단순한 검사장비 제조를 넘어, 반도체 후공정 부품의 이송·가공·편집 공정 전반에 걸친 자동화 기술을 독자적으로 구축하고 있다. '리드프레임 이송장치'(10-2625519)는 진공 니들과 탄성고무 흡착패드를 결합한 비접촉 정밀 이송 구조로 리드프레임의 품질 손상을 원천적으로 방지하며, '리드프레임 데이핑 장치'(10-2567397)는 테이프 공급·커팅·압착의 전 과정을 자동화하여 공정 정밀성을 높인다. 또한 '테이프

성우테크론(045300)

캐리어 패키지 자동 편집장치'(10-2023984)를 통해 TCP·COF 등 테이프형 반도체 디바이스의 불량 제거 및 접합 공정을 완전 자동화함으로써 기존 수작업 대비 생산성을 대폭 향상시키고 있다. 이와 같은 공정 자동화 기술은 임가공 사업부의 공정 손실 최소화와 원가 경쟁력의 핵심 기반으로 작용하고 있다.

그림 7. 동사 LineScan Auto Vision Inspection Machine

• Applied Product

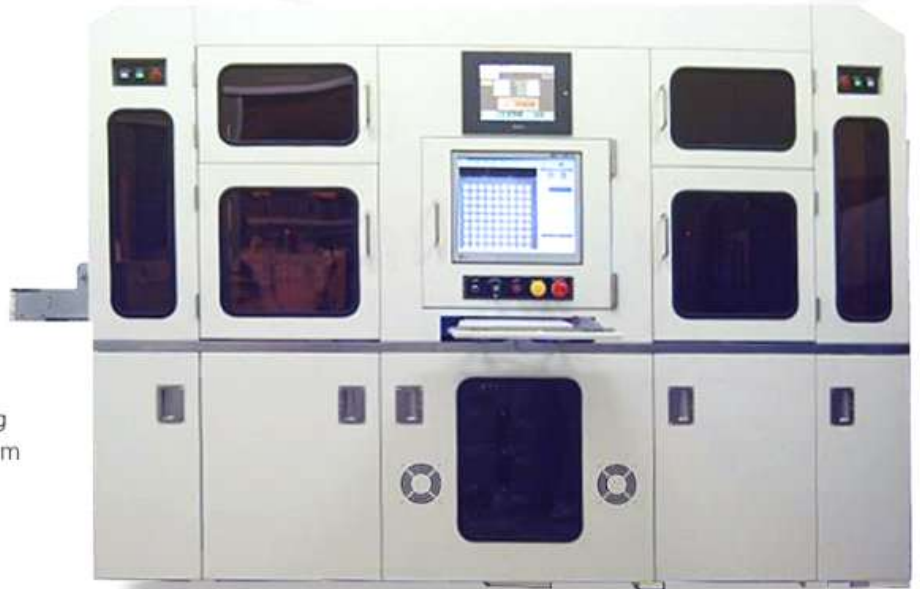
- ALL LEADFRAMES, Premold LED
- Lead frame Material
: Cu ALLOY + Ag / Pd-P.P.F / 42 ALLOY + Ag
W30~110mm, L140~300mm, t0.1~0.5mm

• Tact Time

- MLF, QFN, QFP, SLF
- : AVG. 6sec/strip (10sec/strip - 2scan)

• Detection Spec

(Multi Scan Method used)
Lead Space, Location, Pit/Pin Hole,
Scratch, Imbrued, Oxidation, Plating Area,
Non-Plating, Mouse bite, stain, Noddle,
Plating Shift, etc.



• VRS

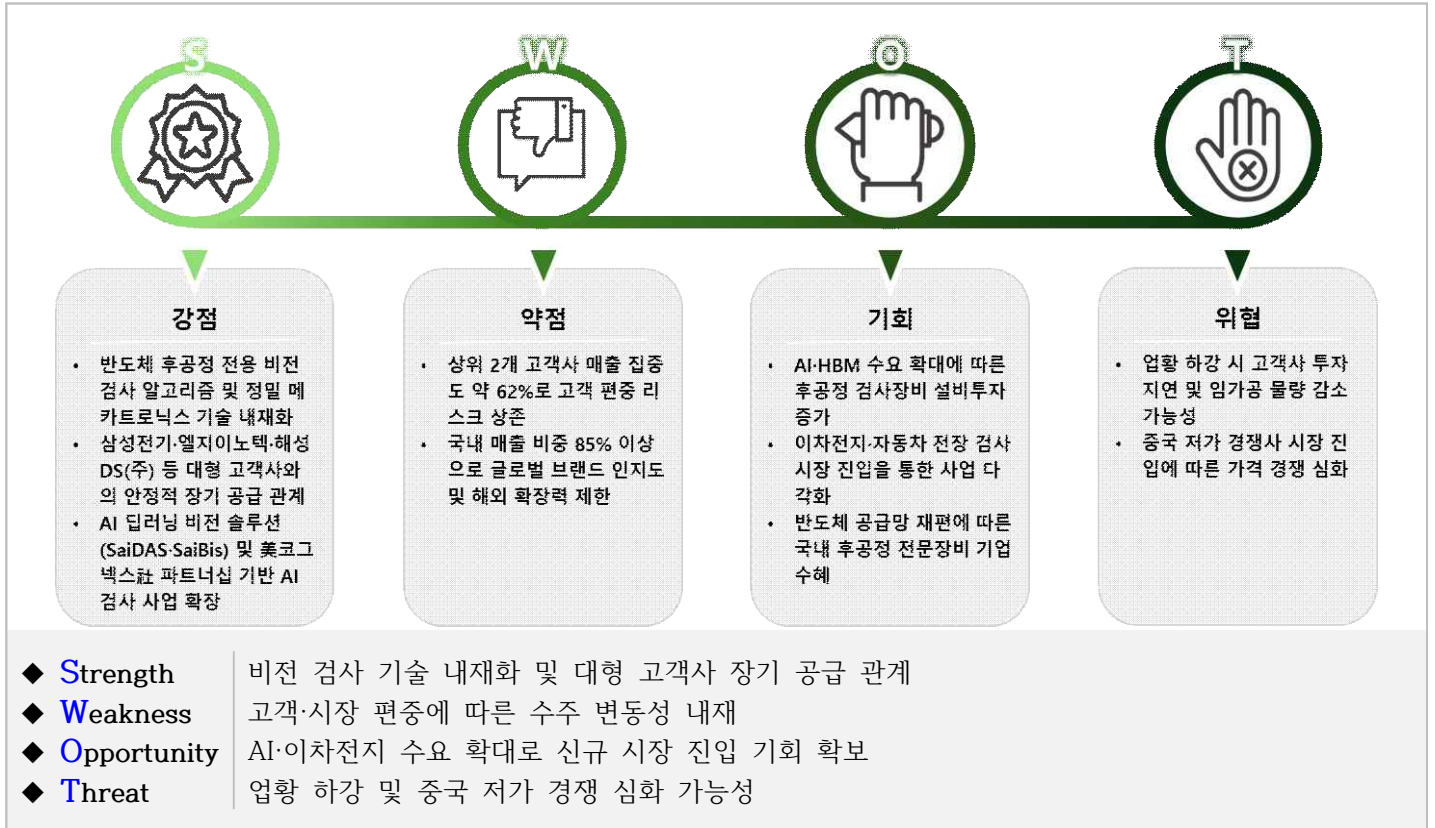


자료: 동사 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

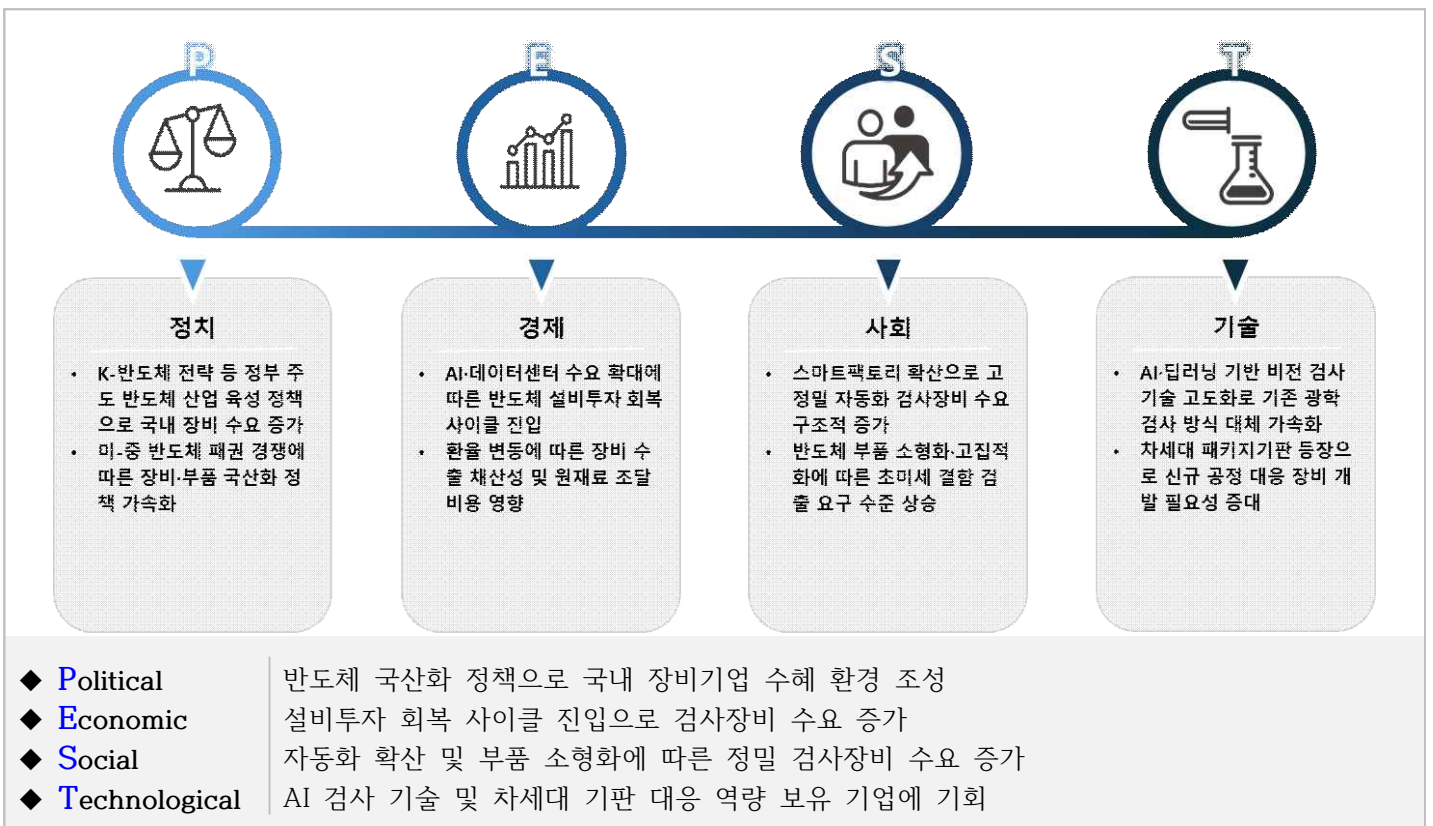
■ AI 딥러닝 비전 솔루션 및 차세대 기판 공정 기술

동사는 축적된 비전 검사 기술을 AI 딥러닝과 결합하여 차세대 검사 솔루션 사업으로 확장하고 있다. 2021년 자체 개발한 딥러닝 기반 AI 비전 검사 솔루션 'SaiDAS·SaiBis'는 리드프레임·PCB·렌즈·모듈 등 다양한 부품의 양산 공정에 적용되고 있으며, 같은 해 미국 코그넥스社(NASDAQ: CGNX)와 PSI 파트너십을 체결하여 AI 솔루션 사업부를 별도로 운영하며 관련 시장 내 입지를 강화하고 있다. 아울러 차세대 고밀도 패키지 기판 공정에 대응하는 '패키지 기판의 커버시트 부착장치'(10-2858635, 10-2674992) 및 '커버시트 제거시스템'(10-2679101)을 연속 등록하는 등 첨단 기판 제조 공정 기술로의 영역 확장을 본격화하고 있으며, 이를 통해 반도체 패키징 고도화 트렌드에 선제적으로 대응하는 기술 기반을 구축하고 있다.

SWOT 분석



PEST 분석



IV. 재무분석

반도체 검사장비 부문 매출 조정 속 부품 임가공 확대로 수익성 개선 본격화

동사는 반도체 검사장비 제조 및 반도체 부품 임가공을 주력으로 영위하며, 2025년 연결 매출액 409.2억 원, 영업이익 19.5억 원, 당기순이익 47.5억 원을 시현하였다. 2026년 1분기에는 매출액 117.8억 원, 영업이익 13.7억 원, 당기순이익 15.9억 원을 시현하며 전년 동기 대비 2.1% 증가한 흐름을 나타내었다.

■ 반도체 검사장비 부문 매출 조정과 부품 임가공 확대

동사는 반도체 검사장비 제조와 반도체 부품 임가공을 주력으로 하는 기업으로, 사업부문은 장비사업부, 부품사업부, PCB임가공의 3개로 구성되어 있다.

동사의 연결 매출액은 2023년 337.8억 원에서 2024년 416.9억 원으로 23.4% 성장한 이후 2025년에는 409.2억 원으로 1.8% 축소된 흐름을 시현하였다. 부문별로 살펴보면 장비사업부 매출이 2024년 164.1억 원에서 2025년 129.4억 원으로 21.2% 축소된 가운데, 부품사업부는 171.1억 원에서 193.7억 원으로 13.2% 성장하였고, PCB임가공도 81.7억 원에서 86.1억 원으로 5.4% 성장하며 부품 임가공 부문 중심의 매출 구조 전환이 뚜렷하게 나타났다.

■ 흑자 회복 기조 정착과 수익성 개선 흐름의 본격화

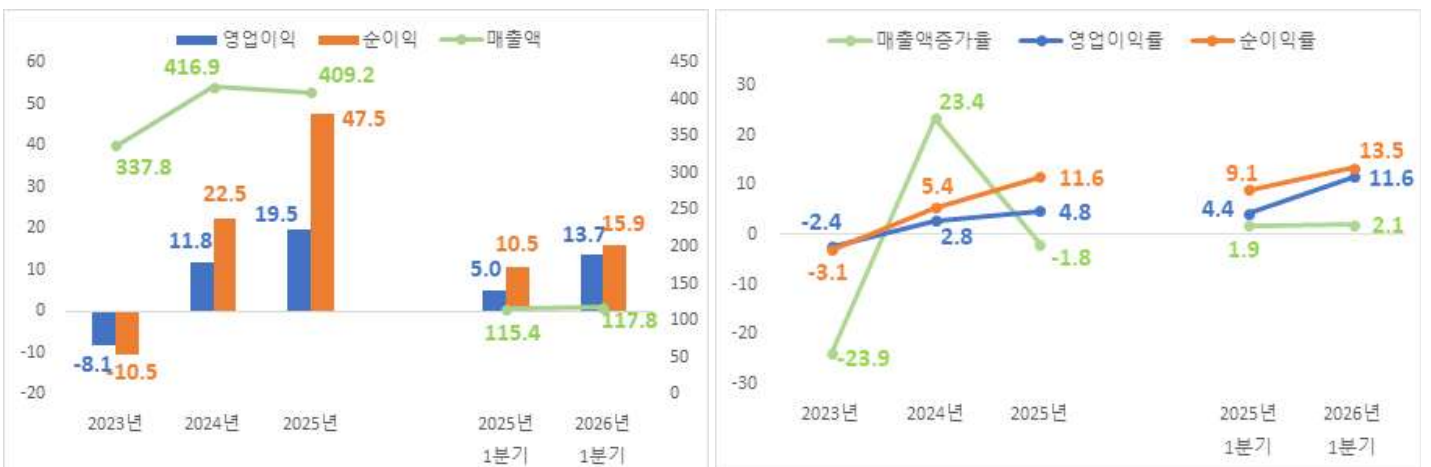
동사의 2024년 연결 영업이익은 11.8억 원, 당기순이익은 22.5억 원으로 전년 적자에서 흑자전환에 성공하며 회복세를 시현하였다. 영업이익률은 -2.4%에서 2.8%로 상승하였고, 순이익률은 -3.1%에서 5.4%로 개선되며 사업 구조조정 효과가 손익 전반에 반영되었다.

2025년 연결 영업이익은 19.5억 원으로 전년 대비 64.9% 성장하였고, 당기순이익은 47.5억 원으로 전년 대비 111.2% 성장하며 수익성 개선 흐름이 한층 확대된 모습을 시현하였다. 영업이익률은 4.8%, 순이익률은 11.6%로 개선되며 매출 구성의 임가공 비중 확대와 원가 효율화가 동시에 반영된 결과로 평가된다.

2026년 1분기에는 매출이 전년 동기 대비 2.1% 증가한 117.8억 원을 나타낸 가운데, 영업이익은 13.7억 원을 기록하였다. 당기순이익은 15.9억 원으로 전년 동기 대비 개선된 흐름을 시현하였다.

그림 8. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

성우테크론(045300)

■ 안정적 재무구조 유지와 현금흐름 창출력 확대 흐름

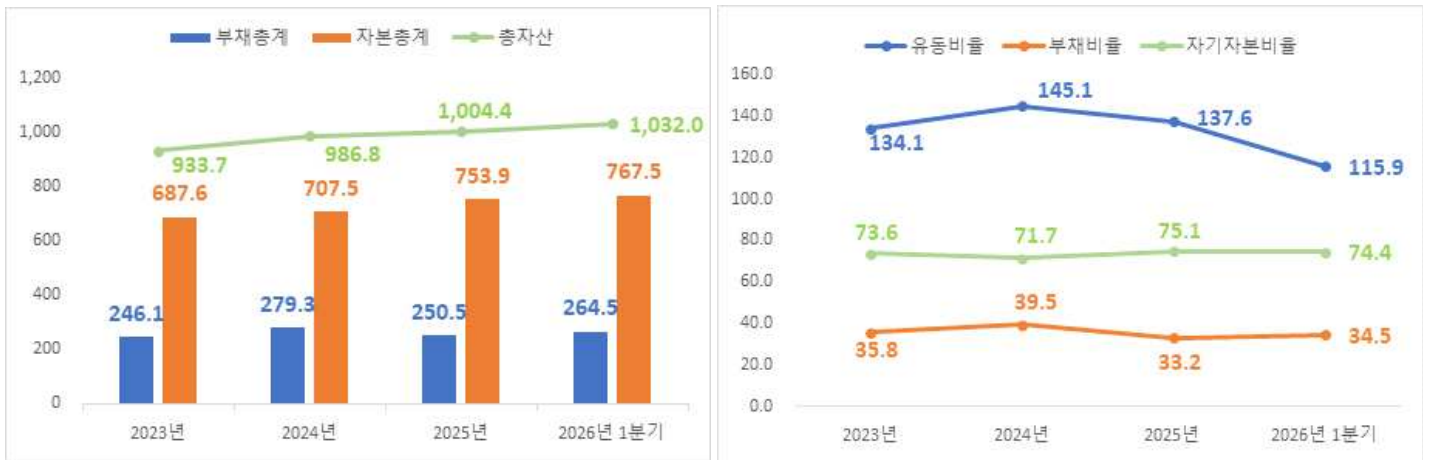
동사의 2024년 말 연결 재무상태는 자산총계 986.8억 원, 부채총계 279.3억 원, 자본총계 707.5억 원으로 전년 대비 자산 5.7%, 부채 13.5%, 자본 2.9%의 변동을 시현하였다.(유동비율 11.0%p 상승한 145.1%, 부채비율 3.7%p 상승한 39.5%, 자기자본비율 2.0%p 하락한 71.7%)

2025년 말 연결 재무상태는 자산총계 1,004.4억 원, 부채총계 250.5억 원, 자본총계 753.9억 원으로 전년 대비 부채는 10.3% 감소하였고 자본은 6.6% 증가하였다.(유동비율 7.5%p 하락한 137.6%, 부채비율 6.3%p 하락한 33.2%, 자기자본비율 3.4%p 상승한 75.1%)

2026년 1분기 동사는 총자산이 전년 동기 대비 59.4억 원 증가한 1,032.0억 원을 기록하였고, 부채총계는 10.5억 원 증가한 264.5억 원, 자본총계는 48.9억 원 증가한 767.5억 원을 나타내었다.(유동비율 5.0%p 상승한 115.9%, 부채비율 0.9%p 하락한 34.5%, 자기자본비율 0.5%p 상승한 74.4%)

그림 9. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

표 3. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2023년	2024년	2025년	2025년 1분기	2026년 1분기
매출액	337.8	416.9	409.2	115.4	117.8
매출액증가율(%)	-23.9	23.4	-1.8	1.9	2.1
영업이익	-8.1	11.8	19.5	5.0	13.7
영업이익률(%)	-2.4	2.8	4.8	4.4	11.6
순이익	-10.5	22.5	47.5	10.5	15.9
순이익률(%)	-3.1	5.4	11.6	9.1	13.5
부채총계	246.1	279.3	250.5	254.0	264.5
자본총계	687.6	707.5	753.9	718.6	767.5
총자산	933.7	986.8	1,004.4	972.6	1,032.0
유동비율(%)	134.1	145.1	137.6	110.9	115.9
부채비율(%)	35.8	39.5	33.2	35.3	34.5
자기자본비율(%)	73.6	71.7	75.1	73.9	74.4
영업현금흐름	27.7	51.0	70.4	-1.9	5.5
투자현금흐름	-46.8	-7.2	-8.2	-17.8	-42.1
재무현금흐름	-4.1	19.2	-45.3	-5.1	-9.5
기말 현금	106.7	170.5	187.2	146.3	141.4

자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

성우테크론(045300)

■ 동사 실적 전망

동사는 글로벌 반도체 경기 회복세에 따른 설비투자 심리 개선이 본격화되면서 장비 부문의 수주 환경이 점진적으로 회복될 것으로 기대된다. 메모리칩 핵심부품 및 후공정 검사 임가공 수요는 기존 거래선과의 협력 심화를 통해 안정적 외형 확장이 지속될 전망이며, 자동차·전자용 검사 분야의 신규 수요 확보를 통한 성장동력 확보 가능성도 점차 가시화되는 것으로 평가된다. 또한 중국·동남아시아 Agency를 통한 해외 마케팅 강화가 추진되고 있어 수출 확대를 통한 외형 다변화도 기대된다.

최근 HBM(고대역폭메모리) 생산능력 확대를 위한 후공정 장비 발주가 본격화되면서 반도체 검사장비 산업 전반의 수주 환경이 비약적으로 개선되고 있다. 동사의 주요 고객인 삼성전기는 2026년 본격적인 양산 설비투자를 계획하고 있으며, LG이노텍의 유리기관 시제품 라인 가동과 함께 해성DS·LG에너지솔루션 등 기존 거래선 물량 및 신규 수주 확대 추진이 진행되는 것으로 파악된다. 또한 AI 반도체 수요 확대에 따른 데이터센터·자동차 전장용 반도체 검사 수요 증가도 동사의 중장기 성장 기회를 확대하는 모멘텀으로 평가된다.

2026년 동사 연결 매출액은 449억 원으로 2025년 대비 9.7% 성장이 예상된다. 부문별로는 장비사업부 145억 원, 부품사업부 212억 원, PCB임가공 92억 원의 매출이 예상되며, 반도체 후공정 수요 확대와 안정적 임가공 수익 기반이 결합되어 외형 확대와 수익성 개선이 동시에 진행될 것으로 기대된다.

그림 10. 동사 사업부문별 실적 및 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



항목	2023	2024	2025	2026E
매출액	337.8	416.9	409.2	449.0
장비사업부	101.1	164.1	129.4	145.0
부품사업부	161.6	171.1	193.7	212.0
PCB임가공	75.0	81.7	86.1	92.0

연도별 실적 및 전망

2026년 실적 및 전망

자료: 동사 사업보고서(2025.12.), 분기보고서(2026.03.), NICE평가정보(주) 재가공

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

차세대 기관 검사 기술·이차전지 시장 진입·AI 솔루션 확장의 3대 성장 축 구축

동사는 신규 특허 등록과 이차전지 검사 시장 진입을 통해 기존 반도체 후공정 중심 사업 기반을 신규 영역으로 확장하고 있다. 아울러 코그넥스 파트너십 기반 AI 솔루션 사업부 확대를 통해 기술 고도화와 시장 다각화를 동시에 추진하며 중장기 성장 기반을 강화하고 있는 것으로 평가된다.

■ 차세대 기관 검사 특허 등록 및 장비 기술 고도화 지속

동사는 2026년 4월 '칼라 고해상도 기관 검사시스템'(10-2953021) 특허를 신규 등록하며 차세대 기관 검사 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있는 것으로 확인된다. 해당 기술은 기관 전·후면을 동시 고속 촬상하여 정밀성을 향상시키고 공정시간을 단축하는 구조로, 고밀도 반도체 패키지 기관 시장 확대에 선제 대응하는 기술 투자로 평가된다. 아울러 2023년 이후 패키지기관 커버시트 부착·제거 관련 특허 3건을 연속 등록하는 등 최근 2년간 총 5건의 신규 특허를 확보하며 지식재산 포트폴리오를 빠르게 고도화하고 있는 것으로 파악된다.

■ 이차전지·전장 검사 시장 진입 본격화

동사는 2025년 2월 인터배터리 2025 전시회에 참가하여 전지 자동검사기 관련 사업 역량을 대내외에 공개하며 이차전지 검사장비 시장 진입을 본격화하고 있는 것으로 확인된다. 동사는 이미 2018년 전지 자동검사기 25대를 납품(70억 원 규모)한 실적을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 이차전지 제조 공정 검사 분야로의 사업 확장을 추진하고 있는 것으로 파악된다. 기존 반도체 검사장비 기술과의 연계성을 통해 배터리 부품 검사 자동화 솔루션을 제공할 수 있는 기술 기반을 갖추고 있어, 전기차 캐즘 이후 본격화될 이차전지 설비투자 재개 국면에서 수혜가 기대된다.

■ AI 솔루션 사업부 확대 및 코그넥스 파트너십 기반 신규 시장 공략

동사는 코그넥스와의 PSI 파트너십을 기반으로 AI 솔루션 사업부를 운영하며 산업용 바코드 리더기·스마트카메라·딥러닝 솔루션 등 다양한 제품군을 공급하고 있는 것으로 확인된다. 코그넥스는 2025년 AI 기반 SLX™ 플랫폼 출시 및 클라우드 기반 원비전(OneVision™) 상용화를 추진하는 등 AI 비전 기술 고도화를 지속하고 있으며, 동사는 이러한 파트너사의 기술 혁신을 국내 제조 현장에 적용하는 공급채널로서의 역할을 강화하고 있는 것으로 평가된다. 자체 개발 딥러닝 솔루션 SaiDAS·SaiBis와 코그넥스 제품군의 결합을 통해 반도체·이차전지·전장 등 다양한 제조 분야로 AI 검사 솔루션 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망된다.

그림 11. 바코드 리더기(DATAMAN 280 Series)



자료: 동사 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

성우테크론(045300)

■ 최근 뉴스 및 향후 전망

프롬프트 : 동사의 최근 뉴스와 향후 전망에 대해 알려주세요

생성형 AI 답변 :

“성우테크론은 현금배당과 차세대 AI 검사장비 개발로 반도체 후공정 분야에서 안정적인 주주 친화 정책과 기술 경쟁력을 확보한 점이 긍정적으로 평가된다. 향후, 글로벌 AI 반도체 시장의 성장에 따른 장비 수요 증가와 창원 소부장 특화단지 인프라를 바탕으로 한 중장기 실적 개선이 기대된다.”

* 출처 : Gemini

증권사 투자의견(하단)

작성기관

투자의견

목표주가

작성일

최근 6개월간 발간보고서 없음.

시장정보(주가 및 거래량)

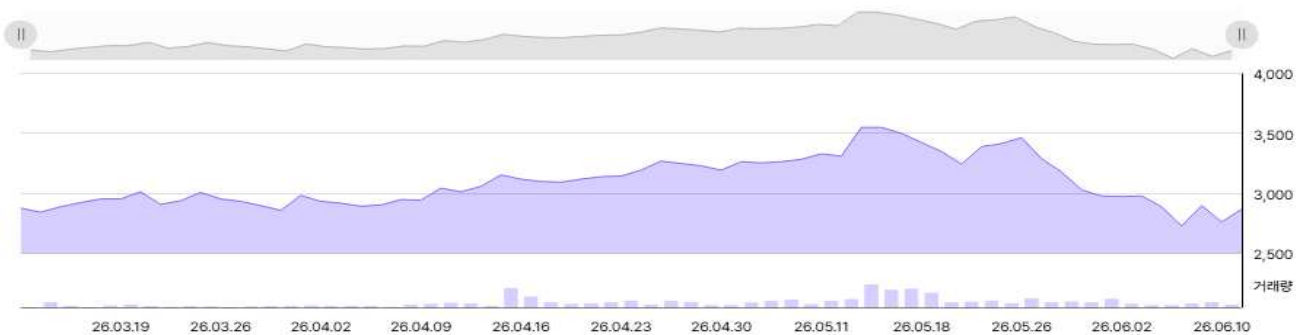
045300 코스닥

단위 : 원, 주, % | 기준 일자 : 2026.06.11

2,870 ▲105 +3.80%

전일 2,765 고가 2,870 거래량 22,286 주
 시가 2,765 저가 2,740 거래대금 62 백만원

1주일 3개월 6개월 1년 3년 5년



자료: NICE Bizline(2026.06.11.)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공 정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
성우테크론	X	X	X